

TECA 電子連接產業升級研討會

光纖通訊基礎理論與共封裝光學相關應用

時間	2025年08月20日(星期三)
主辦單位	台灣電子連接產業協會
地點	新竹工研院-新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號
大綱	1. 光通訊發展與銅線傳輸差異介紹 2. 光纖特性、種類 3. 雷射、光發射器及光接受器介紹 4. 被動光纖纜線及主動式光電傳輸模組介紹 5. 高速傳輸光模組系統介紹 6. 共封裝光學相關運用
適合聽課對象	適合非光電工程人員且對光通訊產業有興趣之學員
預期效益	了解光通訊發展歷程與光通訊傳輸的基本原理，以及現今最熱門的高速傳輸光模組與共封裝光學相關運用的基本知識
講師	朱博士(現職：逢甲大學光電科學與工程學助理教授，經歷：樂榮工業專案經理、總經理特助，專長：高速傳輸、光通訊、矽光子、光學檢測、全像術、白光LED)
09：20-10：40	光通訊發展歷程/光纖傳輸與銅線傳輸差異
10：50-12：10	光纖通訊基本原理
12：10-13：10	午餐時間
13：10-14：30	高速傳輸光模組原理
14：40-16：20	共封裝光學相關運用與機會

★費用：會員NT\$3,800元/人；非會員NT\$7,500元/人；第2位以上報名→半價

(費用含講義/稅，手續費用請自付)

註：1. 欲取消報名需於課程5日前告知，逾時或當日未到課者，恕不退費亦不接受變更其他課用；
2. 課程5日前取消報名課程之退款將扣除學費之10%手續費，於課程結束後統一退費作業！

★參加辦法：請先傳真報名或線上報名並來電確認

匯款或轉帳，土地銀行005 工研院分行 帳號156001000292 戶名 社團法人台灣電子連接產業協會

★聯絡電話：(03)5910002 林小姐，5910003朱小姐 傳真：(03)5910009

★因颱風…等天災，新竹縣或新竹市政府，宣布停止上班，則當日課程另擇期舉行。

◎台灣電子連接產業協會研討會 報名表 ◎

公司全銜	(發票抬頭： <input type="checkbox"/> 同公司名稱 <input type="checkbox"/> 其他_____)				
聯絡地址			統一編號		傳真
E-mail			聯絡人		電話
參加者姓名	職稱/工作部門	午餐	手機	mail	分機
		<input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷			
		<input type="checkbox"/> 素 <input type="checkbox"/> 葷			
費用共計新台幣 元整，支付方式 <input type="checkbox"/> 支票 <input type="checkbox"/> 匯款/轉帳					

註：學員之手機號碼僅做為開課未到聯繫用

(表格如不敷使用請自行影印)1140820光纖通訊